第２８回 有機/無機接合研究委員会

日時：2026 年 6 月 16 日（火）13:00～16:00
場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室（東京都中央区）

プログラム

司会　藤田 晶（化研テック(株)）

13:00～13:10　委員会議事

13:10～13:50　Mate+研究発表賞受賞記念講演

『複合材料の熱伝導現象解析 ―熱伝導率の温度特性メカニズム解明―』（40 分）

…… ○井﨑 泰斗、荒尾 修（(株)デンソー）

13:50～14:30

『接着継手の加速劣化試験―重回帰分析による寿命予測法
　およびスカーフ接着継手の組合せ応力条件下の破壊条件』（40 分）

…… ○鈴木 靖昭（鈴木接着技術研究所）

14:30～14:40　　休憩

司会　新井 進（信州大学）

14:40～15:20

『多層プリント基板の応力解析における平均的弾性率の算出方法』（40 分）

…… ○三嶋 淳也（オムロン(株)）

15:20～16:00

『高温におけるエポキシ樹脂への銅のマイグレーション』（40 分）

…… ○趙 帥捷（富士電機(株)）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会　エレクトロニクス生産科学部会